

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

赣州逸豪新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 -001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与逸豪新材（301176）2024年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年04月28日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 张剑萌 总经理兼董事会秘书 刘磊 董事兼财务总监 曾小娥 独立董事 吴雯雯 保荐代表人 郭振国
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司2024年度营业收入为143,700.99万元，较上年增长12.55%；归属于母公司所有者的净利润亏损3,886.12万元，亏损额较上年增加17.92%，主要原因在于：（1）2024年国内电解铜箔产能扩张速度放缓，但行业整体竞争仍较为激烈，铜箔加工费持续处于历史低位，报告期内，公司铜箔业务毛利率较上年有所下降，预计随着行业竞争，产能逐步出清，供需关系将逐步改善；（2）报告期内，公司单面PCB产品随着产能提升及品</p>

种优化毛利率大幅提升，但公司双多层PCB产品规模效益不足，PCB业务整体仍尚未实现盈利。

2. 请问逸豪新材在战略布局上是否会有新的调整或拓展方向，以实现可持续发展？

答:尊敬的投资者您好！公司坚持产业链垂直一体化发展战略，通过横向扩张铜箔产能，持续提升超薄铜箔和厚铜箔的产量，巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额。同时随着公司募投项目的稳步实施，公司将大幅提升超薄铜箔、厚铜箔及高频高速铜箔等高端电子电路铜箔的产能；此外公司募投项目的设备及工艺，可实现电子电路铜箔和锂电铜箔切换生产，公司将加快锂电铜箔业务布局，将铜箔产品拓展至锂电铜箔领域。公司通过纵向打通产业链，强化公司PCB产品的应用领域，2025年度公司PCB计划通过提升产能利用率，重点提高多层板的产能占比；不断提升PCB技术创新、生产管理和服务能力。在现有的单面铝基PCB、双多层PCB等消费类PCB产品基础上，提升PCB产品结构的多样性和创新性，持续积累提升PCB工艺能力，并重点提升工业自动化、智能终端、Mini LED、智能家居、5G通信、新能源智能汽车等领域PCB产品的应用。

3. 高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答:尊敬的投资者您好！随着电子信息行业的多重积极变量显现，消费电子市场需求呈现明显回暖态势，AI技术革命的爆发式发展催生了全球数据中心扩建浪潮，以英伟达为代表的头部科技企业带动了AI服务器PCB需求的激增。与此同时，新能源汽车渗透率持续突破，车载PCB因800V高压平台普及、智能座舱升级以及自动驾驶技术迭代等需求，使得单车PCB价值量不断提升，为产业链带来新的增长空间。公司作为行业内为数不多的具有PCB垂直一体化产业链布局的企业，公司掌握电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB生产核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。未来随着公司铜箔募投项目的产能释放，在提升规模效应的同时，可有效改善产品结构，提高高附加值铜箔产品的占比；公司PCB业务方面，单面PCB产品随着产能提升及品种优化毛利率大幅提升，公司将持续优化单面PCB产品结构，持续提升该类产品的毛利率；同时公司双多层PCB产品，随着客户拓展，应用领域不断开拓，产能利用率以及盈利水平将不断提升，为公司业绩提供新的增长点。

	<p>4. 请问贵司未来研发重点将聚焦哪些领域？</p> <p>答:尊敬的投资者您好!公司铜箔产品聚焦“易剥离极薄载体铜箔开发”和“低峰值6-120Z超厚铜箔的开发”；铝基板产品聚焦“60 μm超薄绝缘层铝基覆铜板的开发”和“复合导热绝缘层铝基板的开发”；单面PCB产品聚焦60 μm绝缘层厚度铝基PCB耐高压控制技术，双多层PCB产品聚焦新能源汽车车载显示COB PCB品质控制技术、Micro LED高精度焊盘控制技术。</p> <p>5. 后续有啥策略扭亏为盈？</p> <p>答:尊敬的投资者您好!公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额，持续提升产品质量及产品良率，补充高频高速铜箔及超薄高抗拉锂电铜箔生产能力，公司电解铜箔将在产品结构上做出调整，增加以上高附加值产品的占比，提升产品附加值，提高产品竞争力。充分利用自产电子电路铜箔的优势，发挥垂直一体化产业链的协同效应，发展高导热铝基覆铜板相关的业务，以拓展铝基覆铜板的高端应用领域，公司将通过积极拓展国内外市场，持续优化PCB产品结构，调整产能配置，提升多层PCB产能占比，提高高附加值产品的比重。</p> <p>6. 高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。</p> <p>答:尊敬的投资者您好!2024年市场铜箔行业整体竞争仍较为激烈，铜箔加工费持续处于历史低位，铜箔企业普遍面临整体亏损的局面。目前铜箔行业产能扩张速度明显放缓，随着行业洗牌加速，部分产能建设延缓，低端产能将陆续淘汰，产能逐渐出清，供需关系预计将逐步改善。</p> <p>7. 高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。</p> <p>答:尊敬的投资者您好!铜箔市场的需求梯度在不断拓宽加深。随着AI、5G基站、互联网数据中心（IDC）、汽车电子、消费电子等下游产业的快速发展，将驱动PCB以及电子电路铜箔市场保持稳健增长；PCB市场规模在人工智能、数据中心、智能汽车等PCB下游应用领域持续推动下，全球PCB需求总体呈增长态势。根据Prismark最新行业报告2029年全球PCB市场规模预计将达946.61亿美元，2025—2029年年均复合增长率预计为4.8%。其中，2029年中国PCB市场规模预计将达508.04亿美元。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

附件清单（如有）	
日期	2025年04月28日